

## 第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展潜力，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分的内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以实施权益分派股权登记日持有的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。公司总股本170,305,736股，扣除回购专用账户950,416股，可参与利润分配股数169,355,320股，合计拟派发现金红利12,701,643.75元。公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.87%，2024年公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如因实施分配方案时公司股票价格发生变动或实施其他回购的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并另行公告具体调整情况。本事项已提交公司第三届董事会第四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、是否是控股股东治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

9、第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简称

1.2 公司上市未盈利且尚未实现盈利

√适用 □不适用

公司股票简况

股票简称：神工股份 股票代码：688233 变更前股票简称：

A股 上海证券交易所科创板 神工股份 688233 不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

董秘会秘书 证券事务代表

姓名：常亮 宋梦璐

联系地址：辽宁省锦州市太和区中信路46号甲 辽宁省锦州市太和区中信路46号甲

电话：+86-416-711-9889 +86-416-711-9889

传真：+86-416-711-9889 +86-416-711-9889

电子邮箱：info@shenkou.com.cn

2、报告期间公司主要业务简况

2.1 主要产品、服务情况

报告期内，公司抓住下游市场需求回暖的契机，严控成本、加强管理，不仅扩大了大直径硅材料产品的收入规模，还提高了毛利率水平。

硅零部件业务，公司研发投入符合市场需求，市场推广取得进展，营业收入大幅提升，在下游客户方面投入巨资建设的供应链风险后，公司发展了独特的支撑体系，并不断拓展客户。

目前公司主要情况说明如下：

这一业务板块的产品，直接覆盖了从14英寸至22英寸所有规格，主要销售给中国、日本、韩国的下游客户，因此可称之为“集成电路用大直径硅材料”。该产品具有国际竞争力，在技术、品质、产能和市场占有率等方面处于世界领先水平，也是公司的主要营业收入来源。

报告期内，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能逐步提升中；产能继续优化升级，利润率较去年提升了16%以上；产能占比上升至51.61%；成本方面，原生多晶硅材料价格下降，硅片库存量增加，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能得到稳步扩充，产品结构进一步优化，使得公司整体毛利率提升。

在硅零部件领域，公司拥有一个南北两个厂区，配合国内及海外客户向国内集成电路制造厂商提供高精度硅片的生产能力。

随着集成电路制造产能向中国转移以及中国本土等离子刻蚀设备技术的突破，国内市场不断提升，因此公司的大直径硅材料才面向中国市场销售。

公司拟以实施权益分派股权登记日持有的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。

公司总股本170,305,736股，扣除回购专用账户950,416股，可参与利润分配股数169,355,320股，合计拟派发现金红利12,701,643.75元。公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.87%，2024年公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如因实施分配方案时公司股票价格发生变动或实施其他回购的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并另行公告具体调整情况。本事项已提交公司第三届董事会第四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、是否是控股股东治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

9、第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简称

1.2 公司上市未盈利且尚未实现盈利

√适用 □不适用

10、第三节 公司主要业务

10.1 主要产品、服务情况

报告期内，公司抓住下游市场需求回暖的契机，严控成本、加强管理，不仅扩大了大直径硅材料产品的收入规模，还提高了毛利率水平。

硅零部件业务，公司研发投入符合市场需求，市场推广取得进展，营业收入大幅提升，在下游客户方面投入巨资建设的供应链风险后，公司发展了独特的支撑体系，并不断拓展客户。

目前公司主要情况说明如下：

这一业务板块的产品，直接覆盖了从14英寸至22英寸所有规格，主要销售给中国、日本、韩国的下游客户，因此可称之为“集成电路用大直径硅材料”。该产品具有国际竞争力，在技术、品质、产能和市场占有率等方面处于世界领先水平，也是公司的主要营业收入来源。

报告期内，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能逐步提升中；产能继续优化升级，利润率较去年提升了16%以上；产能占比上升至51.61%；成本方面，原生多晶硅材料价格下降，硅片库存量增加，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能得到稳步扩充，产品结构进一步优化，使得公司整体毛利率提升。

在硅零部件领域，公司拥有一个南北两个厂区，配合国内及海外客户向国内集成电路制造厂商提供高精度硅片的生产能力。

随着集成电路制造产能向中国转移以及中国本土等离子刻蚀设备技术的突破，国内市场不断提升，因此公司的大直径硅材料才面向中国市场销售。

公司拟以实施权益分派股权登记日持有的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。

公司总股本170,305,736股，扣除回购专用账户950,416股，可参与利润分配股数169,355,320股，合计拟派发现金红利12,701,643.75元。公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.87%，2024年公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如因实施分配方案时公司股票价格发生变动或实施其他回购的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并另行公告具体调整情况。本事项已提交公司第三届董事会第四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、是否是控股股东治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

9、第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简称

1.2 公司上市未盈利且尚未实现盈利

√适用 □不适用

10、第三节 公司主要业务

10.1 主要产品、服务情况

报告期内，公司抓住下游市场需求回暖的契机，严控成本、加强管理，不仅扩大了大直径硅材料产品的收入规模，还提高了毛利率水平。

硅零部件业务，公司研发投入符合市场需求，市场推广取得进展，营业收入大幅提升，在下游客户方面投入巨资建设的供应链风险后，公司发展了独特的支撑体系，并不断拓展客户。

目前公司主要情况说明如下：

这一业务板块的产品，直接覆盖了从14英寸至22英寸所有规格，主要销售给中国、日本、韩国的下游客户，因此可称之为“集成电路用大直径硅材料”。该产品具有国际竞争力，在技术、品质、产能和市场占有率等方面处于世界领先水平，也是公司的主要营业收入来源。

报告期内，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能逐步提升中；产能继续优化升级，利润率较去年提升了16%以上；产能占比上升至51.61%；成本方面，原生多晶硅材料价格下降，硅片库存量增加，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能得到稳步扩充，产品结构进一步优化，使得公司整体毛利率提升。

在硅零部件领域，公司拥有一个南北两个厂区，配合国内及海外客户向国内集成电路制造厂商提供高精度硅片的生产能力。

随着集成电路制造产能向中国转移以及中国本土等离子刻蚀设备技术的突破，国内市场不断提升，因此公司的大直径硅材料才面向中国市场销售。

公司拟以实施权益分派股权登记日持有的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。

公司总股本170,305,736股，扣除回购专用账户950,416股，可参与利润分配股数169,355,320股，合计拟派发现金红利12,701,643.75元。公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.87%，2024年公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如因实施分配方案时公司股票价格发生变动或实施其他回购的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并另行公告具体调整情况。本事项已提交公司第三届董事会第四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、是否是控股股东治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

9、第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简称

1.2 公司上市未盈利且尚未实现盈利

√适用 □不适用

10、第三节 公司主要业务

10.1 主要产品、服务情况

报告期内，公司抓住下游市场需求回暖的契机，严控成本、加强管理，不仅扩大了大直径硅材料产品的收入规模，还提高了毛利率水平。

硅零部件业务，公司研发投入符合市场需求，市场推广取得进展，营业收入大幅提升，在下游客户方面投入巨资建设的供应链风险后，公司发展了独特的支撑体系，并不断拓展客户。

目前公司主要情况说明如下：

这一业务板块的产品，直接覆盖了从14英寸至22英寸所有规格，主要销售给中国、日本、韩国的下游客户，因此可称之为“集成电路用大直径硅材料”。该产品具有国际竞争力，在技术、品质、产能和市场占有率等方面处于世界领先水平，也是公司的主要营业收入来源。

报告期内，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能逐步提升中；产能继续优化升级，利润率较去年提升了16%以上；产能占比上升至51.61%；成本方面，原生多晶硅材料价格下降，硅片库存量增加，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能得到稳步扩充，产品结构进一步优化，使得公司整体毛利率提升。

在硅零部件领域，公司拥有一个南北两个厂区，配合国内及海外客户向国内集成电路制造厂商提供高精度硅片的生产能力。

随着集成电路制造产能向中国转移以及中国本土等离子刻蚀设备技术的突破，国内市场不断提升，因此公司的大直径硅材料才面向中国市场销售。

公司拟以实施权益分派股权登记日持有的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。

公司总股本170,305,736股，扣除回购专用账户950,416股，可参与利润分配股数169,355,320股，合计拟派发现金红利12,701,643.75元。公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.87%，2024年公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如因实施分配方案时公司股票价格发生变动或实施其他回购的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并另行公告具体调整情况。本事项已提交公司第三届董事会第四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、是否是控股股东治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

9、第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简称

1.2 公司上市未盈利且尚未实现盈利

√适用 □不适用

10、第三节 公司主要业务

10.1 主要产品、服务情况

报告期内，公司抓住下游市场需求回暖的契机，严控成本、加强管理，不仅扩大了大直径硅材料产品的收入规模，还提高了毛利率水平。

硅零部件业务，公司研发投入符合市场需求，市场推广取得进展，营业收入大幅提升，在下游客户方面投入巨资建设的供应链风险后，公司发展了独特的支撑体系，并不断拓展客户。

目前公司主要情况说明如下：

这一业务板块的产品，直接覆盖了从14英寸至22英寸所有规格，主要销售给中国、日本、韩国的下游客户，因此可称之为“集成电路用大直径硅材料”。该产品具有国际竞争力，在技术、品质、产能和市场占有率等方面处于世界领先水平，也是公司的主要营业收入来源。

报告期内，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能逐步提升中；产能继续优化升级，利润率较去年提升了16%以上；产能占比上升至51.61%；成本方面，原生多晶硅材料价格下降，硅片库存量增加，公司大直径硅材料生产情况稳定，产能得到稳步扩充，产品结构进一步优化，使得公司整体毛利率提升。

在硅零部件领域，公司拥有一个南北两个厂区，配合国内及海外客户向国内集成电路制造厂商提供高精度硅片的生产能力。

随着集成电路制造产能向中国转移以及中国本土等离子刻蚀设备技术的突破，国内市场不断提升，因此公司的大直径硅材料才面向中国市场销售。

公司拟以实施权益分派股权登记日刊登在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2024年度报告摘要》为准。

2025年3月25日在公司会议室通过网络投票的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。

三、监事会会议召开情况

(一)会议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2024年度报告摘要》。

(二)会议通过了《关于公司2024年度股东会工作报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2024年度股东会工作报告》。

(三)会议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2024年度监事会工作报告》。</p